

## 芯联集成电路制造股份有限公司

### 关于持股5%以上股东部分股份解质押及质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”或“公司”）股东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“日芯锐”）持有公司股份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅芯锐”）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称“员工持股平台”）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.34%。日芯锐前次累计质押股份 160,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 35.84%，占公司目前总股本的 2.27%。

- 日芯锐本次解质押股份 80,000,000 股，质押股份 90,000,000 股，本次解质押及质押后日芯锐累计质押股份数 170,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 38.08%，占公司目前总股本的 2.41%。

#### 一、本次股份解质押及质押基本情况

公司近日接到股东日芯锐通知，获悉其所持有公司的部分股份解质押及质押。具体情况如下：

##### 1、本次部分股份解质押的基本情况

股东名称	本次解除质押股数（股）	解除质押时间	质权人	占其所持股份比例	占员工持股平台所持股份比例	占公司总股本比例
日芯锐	80,000,000	2024年4月25日	招商银行股份有限公司绍兴分行	37.04%	17.92%	1.14%

##### 2、本次部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占员工持股平台所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
日芯锐	否	90,000,000	是	否	2024年4月25日	至质权人申请解除质押为止	交银国际信托有限公司	41.67%	20.16%	1.28%	归还存量债务及利息
合计	-	90,000,000	-	-	-	-	-	41.67%	20.16%	1.28%	-

3、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

#### 4、本次解质押及质押的原因

前期由于出资金额较大，员工部分入股资金来源于向招商银行绍兴分行申请的并购贷款，金额为1.8亿元。日芯锐根据招商银行的合规要求及招商银行绍兴分行对此的授信方案规定，在公司上市完成后，将其持有的8000万股公司股票进行质押作为并购贷款的增信措施。

本次质押是日芯锐以公司9000万股公司股票进行融资，用于归还招商银行并购贷款的存量债务与利息，同时前次质押给招商银行的8000万股公司股票解质押。

### 三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，日芯锐及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
日芯锐	216,000,000	3.07%	160,000,000	170,000,000	78.70%	2.41%	170,000,000	0	46,000,000	0
硅芯锐	230,400,000	3.27%	0	0	0	0	0	0	230,400,000	0
合计	446,400,000	6.34%	160,000,000	170,000,000	38.08%	2.41%	170,000,000	0	276,400,000	0

注：以上所有表格中的比例以四舍五入的方式保留两位小数，数据尾差为数据四舍五入相加所致。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日